BL-14A, BL-14B / 2019G606

新積分型 SOI ピクセル 検出器を用いた X 線残留応力の精密測定と CT 測定 法の 開発

Precised X-ray Residual Stress (RS) Measurement and Development of RS CT Measurement method, using New Integration-type SOI pixel detector

西村龍太郎^{1,*},岸本俊二¹,新井康夫¹,三好敏喜¹,佐々木敏彦²,三井真吾³,新谷正義⁴, 神谷好郎⁵,村田 次郎⁶,若田真来⁶,今井皓⁶,菊地武⁶ ¹高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

²金沢大学, 〒920-1192 金沢市角間町

3 滋賀大学,〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1丁目1-1

4石川県工業試験場,〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地

⁵東京大学,〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

6立教大学,〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1

Ryutaro NISHIMURA^{1,*} Shunji KISHIMOTO¹, Yasuo ARAI¹, Toshinobu MIYOSHI¹, Toshihiko SASAKI², Shingo MITSUI³, Masayoshi SHINYA⁴, Yoshio KAMIYA⁵, Jiro MURATA⁶, Maki WAKATA⁶, Kou IMAI⁶ and Takeshi KIKUCHI⁶ ¹High Energy Accelerator Research Organization, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan ²Kanazawa University, Kakumamachi, Kanazawa, Ishikawa, 920-1192, Japan ³Shiga University, 1-1-1 Banba, Hikone, Shiga, 522-8522 Japan ⁴Industrial Research Institute of Ishikawa, 2-1 Kuratsuki, Kanazawa, Ishikawa, 920-8203, Japan ⁵University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Japan ⁶Rikkyo University, 3-34-1, Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo Japan

1 <u>はじめ</u>に

本課題は KEK 素核研・新井教授を中心とする SOIPIX グループにおいて開発された積分型 SOI ピク セル検出器 INTPIX シリーズの性能評価、及び、残 留応力測定への応用を目的として行うものである。 本課題においては

- INTPIX シリーズ、及び、INTPIX4 を基に商用 化を視野に入れて再設計された検出器 INTPIX4NA に関する性能評価と新たな測定へ の応用の探索
- ・ INTPIX シリーズによる金属材料等の高速・高 精度な残留応力測定と新手法 (残留応力分布回 復法、課題採択時仮称"CT 測定法")の検証

の2つを主な研究目的とした。

2 実験

■新検出器 INTPIX4NA の性能評価

新たに開発した検出器 INTPIX4NA(832×512 ピク セル、17um ピッチ正方画素搭載[1]) について、BL-14A、BL-14Bを用いてエネルギー分解能、ゲイン特 性、解像特性、最小セトリング時間の評価を実施し た。エネルギー分解能については、BL-14Aにおい て、検出器上の特定ピクセルに対してφ3um ピンホ ールによる細径ビームを入射し、周辺8 ピクセル(光 子由来の電荷拡散範囲)との合算のアナログ出力値

のピーク分布を測定し、1光子由来のピークの半値 全幅(FWHM、Full Width at Half Maximum)とピーク 中央値(Hpeak)によって定義されるエネルギー分解能 R = FWHM/Hpeak × 100 (%)を求めることによっ て評価を行った。ゲイン特性についてはエネルギー 分解能測定のデータより光子数毎のピークについて ピーク中央値と収集光子数を換算して得られる収集 電荷量の対応関係から電荷量当たりのアナログ出力 値を求めることによって評価を実施した。解像特性 については、BL-14Bにおいて、ニッケルメッキが 施されたステンレス針によって得られたエッジ像を 斜めエッジ法によって解析し、MTF(Modulation Transfer Function)を求めることによって評価した。 最小セトリング時間(特定ピクセル選択後アナログ 出力応答が安定するのにかかる時間)については、 BL-14Aにおいて、エネルギー分解能測定と同様の 試験についてセトリング時間を変更して繰り返し実 施し、エネルギー分解能が一定の値に収束する最小 時間の探索を行った。BL-14A、BL-14Bにおけるセ ットアップの写真をそれぞれ図1、図2に示す。



図1 BL-14A INTPIX4NA 設置セットアッフ



図 2 BL-14B INTPIX4NA 設置セットアッフ

■金属材料の高精度な残留応力分布の測定・新手法 (残留応力分布回復法)の確立

INTPIX4NA と X-Y 軸自動ステージを用いた残留 応力分布測定用セットアップ(図 3)を BL-14A に構築 し、金属試料の測定を実施した。本セットアップに おいては、E= 5.1-18.5 keV、φ 1mm 程度の細径単色 光 X 線ビームが使用可能である。



図3 BL-14A残留応力分布測定セットアップ

本セットアップにおいては、従来実施されてきた1 測定点毎のメッシュ測定[2]に加えて、ビームを照射 しながら自動ステージによる揺動を行い、揺動範囲 の平均応力値を測定する手法も実施可能である。 新手法(残留応力分布回復法)においては、この揺動 測定法を用いて試料面のあらゆる方向に十分に細か いピッチで揺動測定を繰り返し実施(図4)し、各方 向の平均応力値を取得する。得られた各方向の平均 応力値を応力分布の投影像であるとみなして、X線 CT等でも用いられる逆投影法を用いて再構成する ことによって元の応力分布を復元することを試み る。本手法は、従来の測定法ではビーム照射範囲内 の結晶数が不足するために残留応力測定が難しかっ た試料に対しても測定を可能とする手法となる。



図4 揺動測定による試料の各走査方向の応力値分 布取得の概略

3 結果および考察

■新検出器 INTPIX4NA の性能評価

○エネルギー分解能

測定結果を図5~7に示す。一部の測定については 素子特性の評価データ取得のために 2019G608 の課 題内において実施したものが含まれるが、後述のゲ イン計算に用いているため併せて示す。

測定対象としたピクセルについて、エネルギー分解 能は 5.415 keV では 35.3%-46.2%、8 keV においては 21.7%-35.6%、12 keV においては 15.7%-19.4%であ った。





図 7 12 keV 単色光による光子数別ピーク

○ゲイン特性

8keV および 12keV において得られた 1~3 光子ピ ークのデータを用いて算出したゲイン特性を図 8 に 示す。測定対象としたピクセルについて、ピクセル ゲインは 9.3–10.6 μV/e であった。使用したピクセル のピクセルアレイ上における位置によってばらつき が確認されたが、いずれも良好な線形性を示してお り、簡易な補正処理で対応可能な範囲であった。



図8 ピクセル(412,290)付近のゲイン特性 ○解像特性

ピクセルアレイ上 Column 方向、Row 方向それぞれの MTF プロットを図 9、図 10 に示す。ナイキスト周波数(29.4 cycle/mm)における MTF はピクセルアレイの Column 方向・Row 方向のいずれにおいても50% 以上を記録し、また 50% MTF および 10% MTF はナイキスト周波数を大幅に超える値を示した。



図 9 ピクセルアレイ Column 方向の MTF データ Modulation Transfer Function



図 10 ピクセルアレイ Row 方向の MTF データ

○最小セトリング時間

試験セットアップにおいて、出力特性を維持でき る最短のセトリング時間は1ピクセル当たり200 ns であった。これは INTPIX4NA 全体を読みだした場 合のフレームレートで153 fps に相当する。また、出 力特性の低下が許容できる場合は1ピクセル当たり 80 ns(フレームレート換算350fps)まで短縮すること が可能であることが確認された。セトリング時間と エネルギー分解能のプロットを図11に示す。

Scan Time vs Energy resolution



図11 セトリング時間(ScanTime)を変更した場合の エネルギー分解能プロット

■金属材料の高精度な残留応力分布の測定・新手法 (残留応力分布回復法)の確立

新手法開発のための測定において、用いた試料は 表面に K の字型のショットブラスト加工を施し圧縮 応力分布を持たせた SS400 材(50mm×500mm、テ クノセイキ製、図 12)である。 σ_x (サンプル X 方向 垂直応力)について、直径 26mmの測定範囲を設定し、 7keV ϕ 1mm ビームによる 1mm ピッチ・26 ライン走 査を 3°ステップで繰り返し実施し、61 方向分の分 布データを得た。

得られたデータについて測定条件を反映した補正を 適用したフィルター関数を用いて逆投影法を行い、 図に示す分布復元像を得た(図 13)。本分布像におい て、Kの字型の加工部については-100~-880MPaの 範囲の応力値、未加工部については+30~+1000MPa 程度の応力値を示している。



図12 試料写真(測定範囲を赤線で図示)



図 13 応力分布復元像

4 <u>まとめ</u>

本課題の実施によって、INTPIX4NA検出器の性能 評価、および、放射光を用いた X 線残留応力測定系 の構築と残留応力分布回復法開発を実施した。 INTPIX4NA 検出器については概ね期待される性能 が得られていることが確認された。また、残留応力 分布回復法については測定を実施した試料について、 加工条件を反映した応力値分布が復元されており、 本手法が有効である可能性を示すことができた。 今後は 2021G614 課題の下で試験を継続する予定で ある。

参考文献

- [1] "INTPIX4NA" new integration-type silicon-oninsulator pixel detector for imaging application.
 R.Nishimura et al. s.l.: IOP, 2021, JINST, Vol. 16, P08054.
- [2] Fine residual stress distribution measurement of steel materials by SOI pixel detector with synchrotron Xrays. R.Nishimura et al. s.l. : Elsevier, 2020, NIMA, Vol. 978 164380.
- * ryunishi@post.kek.jp